

超柔软导热硅胶片

TP300-H30-S是一款超柔软的硅胶垫片，在低压力下即可实现较低热阻与高形变，具备优异的缝隙填充能力，尤其适用于公差较大的装配平面。此外，该产品带有自粘性，无需额外使用可能影响导热性能的背胶层。



特性和优点

- 导热系数：3.0W/(m·K)
- 双面自粘
- 高电气绝缘
- 玻纤/PI膜加强可选
- 低压缩力应用，具有高压缩比

典型应用

- LCD背光模块
- 网络通讯设备
- 高速大存储驱动
- 汽车发动机控制单元

典型属性		
属性	典型值	测试方法
颜色	浅蓝色	目视
厚度 (mm)	1.0~10.0	ASTM D374
密度 (g/cc)	3.0	ASTM D792
硬度 (Shore 00)	30	ASTM D2240
重量损失 (%，挥发、渗出)	≤0.8	滤纸吸附 @压缩25%,125°C,48h
耐温范围 (°C)	-40~150	/
防火性能	V-0	UL 94
保质期 (月)	12	温度<40°C避免挤压、暴晒
电性能		
击穿电压 (kV/mm)	≥6.0	ASTM D149
介电常数	7.3	ASTM D150 @10MHz
体积电阻率 (Ω·cm)	10 ¹³	ASTM D257
导热性能		
导热系数 (W/(m·K))	3.0	ISO 22007-2